

XJP-600 多功能测量显微镜



产品用途

XJP-600 多功能测量显微镜是针对半导体工业、硅片制造业、电子信息产业、冶金工业开发的，也可作为高级金相显微镜使用。可用于鉴别和分析各种金属和合金的组织结构，可广泛应用在工厂或实验室进行铸件质量的鉴定、原材料的检验或对材料处理后金相组织的研究分析等。该仪器设计符合人机工程学要求，使您在工作中感到舒适和轻松。

产品规格

规格参数			XJP-600
光路系统	无限远校正光学系统		
观察头	正像、人性化 0~45°任意可调、瞳距调节：55mm-75mm		
目镜	WF10X/ 25mm、WF10X/ 20mm 带 0.1 十字分划板		
长距离无限远平场复消色差物镜	倍率	数值孔径(N.A.)	工作距离(W.D.)
	5×	0.15	44
	10×	0.3	34
	20×	0.35	30
	50×	0.5	17
放大倍数	500×		
测量工作台	测量平台	X 轴移动范围	100mm
		Y 轴移动范围	100mm
		调焦方式	手动
		测量方式	线性编码器(X-Y-Z)
		数显分辨率(mm)	0.001/0.005/0.0005
		浮动功能	X-Y 快速断开
	载物台直径	286×286mm	
中心玻璃台直径	180×180mm		
玻璃台载重	5KG		

检测尺	0.01mm 测微尺	
DIC 装置	DIC 棱镜插孔四孔转换器	
偏光装置	检偏镜可 360 度转动，起偏镜、检偏镜均可移出光路	
调焦机构	调焦手轮进行上下调焦	
照明系统	下光源照明：12V/50W 卤素灯，带可调整光圈远心照明系统，亮度可调	
	上科勒照明：12V/50W 卤素灯，带可调视场光阑和孔径光阑，亮度可调	
仪器尺寸	长宽高：262*220*325mm	
可升级配件	目镜：15× 20×	
	物镜：2 × 100×	
	角度分度值	
	高质量成像系统	
	二维测量软件	

注解： 为标配、 为可升级配件

特别声明：

- 普丹会尽全力为您提供准确、全面的信息，但不对信息中可能出现的错误或遗漏承担责任。
- 产品图片仅供参考，请以销售实物为准。
- 以上内容如有变动，恕不另行通知。